

LCP 日本上野 5030G BK连接器专用LCP塑胶原料价格咨询

产品名称	LCP 日本上野 5030G BK连接器专用LCP塑胶原料价格咨询
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。LCP塑胶原料是防火安全性好的特种塑料之一。

LCP塑胶材料适用于多种间距系列的排母汽车连接器产品的生产上，耐焊接温度在260度-320度之间。这种材料线膨胀系数小，注塑成型收缩率低、强度和弹性模量好、耐热性优良，具有较高的负荷变形温度，还具有优良的耐化学药品和气密性，因此一般连接器尤其需要SMT的都偏爱选择LCP材料。

一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;

塑胶原料的疲劳数据还很少,需根据使用要求加以考虑。

塑胶原料：是由高分子合成树脂(聚合物)为主要成份渗入各种辅助料或某些具有特定用途的添加剂，在特定温度，压力下具有可塑性和流动性，可被模塑成一定形状，且在一定条件下保持形状不变的材料。

LCP塑胶原料具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。作为电器应用制件，在连续使用温度200~300 时，其电性能不受影响。而间断使用温度可达316 左右。

本公司品种，货源充足，产品原厂原包，，批量采购，原料可提供：MSDS、COC、UL黄卡、SGS报告、物性表、材质证明及物质安全资料表、增值税等。公司一贯秉承“良好的信誉，诚信的合作”方针；“客户至上，品质为本”是我们的准则；“为客户降低生产成本，”是我们努力的方向。因本公司品种繁多，只能提供部分型号供参考，如需其它型号请来电咨询洽谈！

电子电气工业的导线绝缘、电缆护套、插座、接线柱、线圈骨架、继电器、电器零部件、电容器薄膜，配电盘零件等。还可用作防腐包装材料和涂料。

减摩、耐磨性能好 大多数塑胶原料具有优良的减摩、耐磨和自润滑性能，它们既可以在水、腐蚀介质中正常工作，也可在边界摩擦和干摩擦条件下有效地工作，比金属要低很多，只有金属要好得多，通常塑胶原料的摩擦系数，比金属要低得多，只有金属的几分之一到十几分之一，因此可用塑胶原料制作许多减摩和耐磨制品。

光学级医疗级COC 照明灯具镜框架COC材料 透光率92% 镜头摄像头COC树脂

很不耐酸，不耐强碱和不耐紫外线的辐射。(加入UV剂，能大大提高其耐紫外线等级)

LCP塑胶原料全称LIQUID CRYSTAL POLYMER，中文名称液晶聚合物。

工程塑料 通用塑料的价格虽低廉，但是它的力学性能，耐温、耐蚀性能均难以满足某些工程和设备中用作结构材料的需要，为此工程塑料应运而生，它机械强度高，刚性大，能取代某些钢铁或有色金属材料，可制造结构复杂的机械零件或工程受力件，很多使用效果还超过原来的材料，常用的工程塑料有PA、ABS、PSF、PTFE塑胶原料、POM塑胶原料、PC等。

PBT塑胶材料常被用于生产2.54间距180度/90度的排母连接器产品之上，塑料端子壳的耐焊接温度只有200度左右，由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性，现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚矾等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。